

半导体国产化势在必行

—电子周报 20210927

电子周报

2021年09月27日

报告摘要:

● 半导体国产化势在必行

我们反复强调，中国关系升温或遇冷只是影响短期国产替代节奏，但半导体自主可控是未来十年坚定不移的大方向。

1) 自主可控是长期方向，2014年至今国家层面不断出台政策支持，包括：

① 税收优惠：实行“两免三减半”，新老政策衔接不断扩大优惠范围（2016年49号文、2020年8号文、2021年9号文）

② “十四五”（2021-2025）着重强调产业链自主可控。

③ 2021年7月，中央、国务院发文，明确浦东半导体企业税收优惠、强调打造世界级创新产业集群。

2) 除封测外，其他环节国产化率均较低，持续看好国产替代大趋势。

① 设计：指纹识别(30%~35%)、CIS(15%~20%)、分立器件(10%~15%)、MCU(5%~10%)、其他产品(MPU、FPGA、模拟等)不足5%。

② 设备：刻蚀<20%，光刻、PVD/CVD<10%。

③ 材料：硅片<10%、电子气体约35%、光刻胶<5%。

④ 代工：大陆龙头中芯和第二华虹全球市占率分别为5%/1%。

⑤ EDA、IP被海外巨头垄断。

● 市场小幅下跌，半导体上涨1.92%

上周(2021/9/20~2021/9/24)市场小幅下跌，半导体指数上涨1.92%。其中：半导体设计+2.3%、半导体制造-2.4%、半导体封测-0.8%、半导体材料-0.1%、半导体设备+6.0%、功率半导体+2.0%。

上周费城半导体指数小幅上涨，涨幅为0.96%，2021/1/1-2021/9/24涨幅为23.55%。台湾半导体指数上周下跌0.32%，2021/1/1-2021/9/24涨幅为17.18%。截至上周(2021/9/24)，A股半导体公司总市值达31,310亿元，同比+25%，对应2021年整体PE为59倍。

● 重点新闻

1) 台积电先进封装技术暨服务副总经理廖德堆近日在某高科技智能制造论坛表示，为达到先进小芯片封装制造的上市时间、量产和良率的目标，台积电正打造创新的3D Fabric先进封测制造基地，将采全自动化，台积电积极打造创新的3D Fabric先进封测制造基地，将由紧密连接的3座厂房所组成，其中SoIC厂房将于今年导入机台，另一2.5D先进封装厂房预计明年完成。

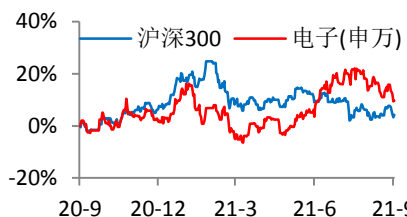
2) 9月22日，据上交所披露，上海概伦电子首发申请获准，将于上交所科创板上市。至此，这家国产EDA厂商的科创板上市之路已跨过关键一道坎，距离成功登陆科创板更进一步。

● 细分板块跟踪

推荐

维持评级

行业与沪深300走势比较



资料来源：Wind，民生证券研究院

分析师：王芳

执业证号：S0100519090004

电话：021-60876730

邮箱：wangfang@mszq.com

分析师：杨旭

执业证号：S0100521050001

电话：021-60876730

邮箱：yangxu_yj@mszq.com

分析师：王浩然

执业证号：S0100521040001

电话：021-60876730

邮箱：wanghaoran@mszq.com

研究助理：赵晗泥

执业证号：S0100120070021

电话：021-60876730

邮箱：zhaohanni@mszq.com

相关研究

1.【民生电子】行业点评：新能源车销量超预期，高景气长周期开启

2.【民生电子】半导体周跟踪：产业趋势向上明确，短期波动不改高景气

代工：代工厂业绩强劲，产品涨价趋势不变。

华虹上海三个 8 寸产能利用率依然高企，展望今明两年都会维持满产状态，稼动率能够维持 110%甚至更高。同时预计今年下半年各产品平台毛利率还将继续提升，21Q3 整体毛利率指引为 25%-27%。中期来看，公司的订单/业绩有望持续向上，一方面因为公司下游应用领域广泛，全面覆盖功率半导体、手机、智能家电、智能电表、IoT、汽车电子等行业，受单一领域需求变动影响较小；另一方面，受益公司本身产品结构升级和国产替代订单增加双重利好。

设备：从近期中微公司调研中了解到：

- 1) 下半年 Mini LED 带动 LED 行业回暖，中微公司今年 6 月既已有部分 Mini-LED MOCVD 设备规模订单进入最后签署阶段。此外，近期跟踪的其他 Mini LED 产业链相关公司业务也正在起量，如新益昌 1H21 Mini LED 固晶机营业收入同比增长 308%。
- 2) 新品进展：3D NAND 是未来刻蚀设备的主要驱动力之一，其中刻蚀工艺最卡脖子的还是深孔深沟的刻蚀。市场上目前普遍使用的高深宽比刻蚀设备高深宽比大概是 40:1 到 50:1，中微公司目前在实验室已经可以做出深宽比超过 60:1 的极高深宽比 CCP 介质刻蚀机，但设备的稳定重复使用还需要进一步努力提升。

材料：硅外延片产能不足与涨价旋律不变，北京科华光刻胶大客户订单进展顺利。

(1) 国内主要抛光片和硅外延片公司产能自 2020 年下半年开始一直处于满产状态，6 英寸与 8 英寸产品均经过多次提价。主要用于生产功率半导体、模拟电路和集成电路 CMOS 的 12 英寸产能更是紧缺，目前国内仅有立昂微、中环等少数公司能够批量供应，并且产能较小，难以满足国内各大下游制造厂商的需求。国外大规模制作功率外延片的仅英飞凌和 SUMCO，在当下缺芯背景下，较难给国内厂商大批量供货。其他国外厂商均重点布局逻辑、存储外延片，功率用外延片产能同样紧缺。

(2) 彤程新材光刻胶子公司北京科华新增包括 KrF 光刻胶、高档 I 线光刻胶、化学放大大型 I 线光刻胶在内的 10 支产品，获得长江存储、中芯北方、广州粤芯、厦门士兰集科等用户订单。北京科华作为唯一被 SEMI 列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司，G/I 线光刻胶在国内 6 寸市场占有率在 60%以上，KrF 光刻胶已经批量供应国内主要的 12 英寸、8 英寸晶圆工厂，能提供 14nm 以上制程所需要的大部分 KrF 光刻胶。客户覆盖中芯国际、华虹半导体、士兰微等国内主要半导体厂商。未来随着彤程新子公司彤程电子更高分辨率/更高制程的 ArF 研发平台建成，公司高端光刻胶产品矩阵将继续扩充。

● 风险提示

下游代工厂扩产进度可能不及预期、国内厂商先进技术发展可能不及预期、行业景气度持续不及预期。

盈利预测与财务指标

代码	重点公司	现价 9月24日	EPS			PE			评级
			2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	
603501.SH	韦尔股份	240	3.12	5.20	7.36	77	46	33	推荐
603986.SH	兆易创新	150	1.32	2.92	4.21	114	51	36	推荐
300782.SZ	卓胜微	351	3.22	6.51	8.70	109	54	40	推荐
300671.SZ	富满电子	115	0.49	4.85	7.08	235	24	16	推荐
688608.SH	恒玄科技	248	1.65	4.33	5.82	150	57	43	推荐
688595.SH	芯海科技	95	0.89	1.12	2.26	106	85	42	推荐
300661.SZ	圣邦股份	320	1.23	2.26	3.06	261	142	105	NA
688536.SH	思瑞浦	580	2.30	4.25	6.33	253	136	92	NA
688018.SH	乐鑫科技	200	1.30	3.53	4.86	154	57	41	推荐
603160.SH	汇顶科技	106	3.63	2.48	3.41	29	43	31	推荐
600460.SH	士兰微	61	0.05	0.68	0.88	1263	90	70	推荐
688396.SH	华润微	70	0.73	1.88	2.19	95	37	32	推荐
300373.SZ	扬杰科技	45	0.74	1.33	1.65	61	34	27	NA
603290.SH	斯达半导	385	1.13	2.18	3.03	341	177	127	推荐
605111.SH	新洁能	121	0.98	2.78	3.25	123	44	37	推荐
3898.HK	中车时代电气	36	2.08	2.17	2.47	17	17	15	NA
600745.SH	闻泰科技	96	1.94	2.68	3.64	49	36	26	推荐
300623.SZ	捷捷微电	31	0.38	0.66	0.84	81	47	37	NA
002371.SZ	北方华创	383	1.08	1.64	2.34	355	233	163	NA
688200.SH	华峰测控	516	3.25	6.70	9.67	159	77	53	推荐
688012.SH	中微公司	163	0.80	0.90	1.15	204	181	142	推荐
688037.SH	芯源微	248	0.58	1.10	1.99	427	227	125	推荐
688630.SH	芯基微装	57	0.59	0.92	1.27	97	62	45	推荐
002409.SZ	雅克科技	80	0.87	1.28	1.72	92	63	46	推荐
688019.SH	安集科技	243	2.89	2.88	3.97	84	84	61	NA
300666.SZ	江丰电子	44	0.65	0.73	0.97	67	60	46	NA
603650.SH	彤程新材	54	0.69	0.85	1.09	79	64	50	推荐
688268.SH	华特气体	89	0.89	1.28	1.70	100	70	52	推荐
688106.SH	金宏气体	26	0.41	0.53	0.66	65	49	40	推荐
300054.SZ	鼎龙股份	20	-0.17	0.32	0.45	-118	63	45	NA
688981.SH	中芯国际	54	0.55	1.32	1.46	99	41	37	推荐
1347.HK	华虹半导体	42	0.59	0.98	1.22	70	43	34	NA
600584.SH	长电科技	32	0.73	1.29	1.54	44	25	21	NA
002156.SZ	通富微电	19	0.25	0.64	0.89	75	30	21	推荐
000021.SZ	深科技	15	0.55	0.54	0.67	27	27	22	推荐

资料来源: Wind、民生证券研究院

注: 韦尔股份、兆易创新、卓胜微、富满电子、恒玄科技、芯海科技、乐鑫科技、汇顶科技、士兰微、华润微、斯达半导、新洁能、闻泰科技、华峰测控、中微公司、芯源微、芯基微装、雅克科技、彤程新材、华特气体、金宏气体、中芯国际、通富微电、深科技采用民生证券预测值, 其他公司采用 wind 一致预期。

目录

1 行情回顾：市场小幅下跌，半导体上涨 1.92%.....	5
2 行业新闻	11
插图目录	13
表格目录	13

1 行情回顾：市场小幅下跌，半导体上涨 1.92%

上周(2021/9/20~2021/9/24)市场小幅下跌,沪深300指数下跌0.13%,上证综指下跌0.02%,深证成指下跌0.01%,创业板指数上涨0.46%,中信电子上涨0.68%,半导体指数上涨1.92%。其中:半导体设计+2.3%、半导体制造-2.4%、半导体封测-0.8%、半导体材料-0.1%、半导体设备+6.0%、功率半导体+2.0%。

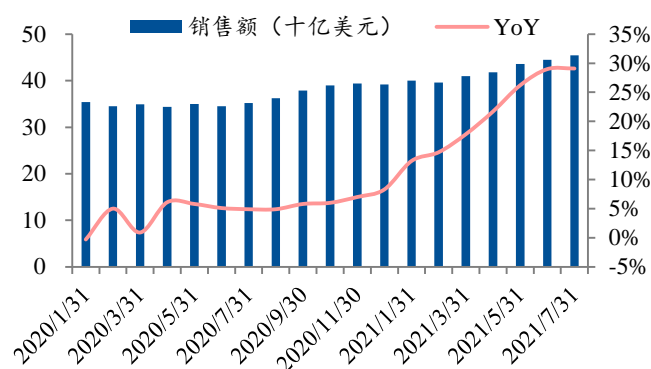
上周费城半导体指数小幅上涨,涨幅为0.96%,2021/1/1-2021/9/24涨幅为23.55%。台湾半导体指数上周下跌0.32%,2021/1/1-2021/9/24涨幅为17.18%。

图1: 费城半导体指数持续上涨



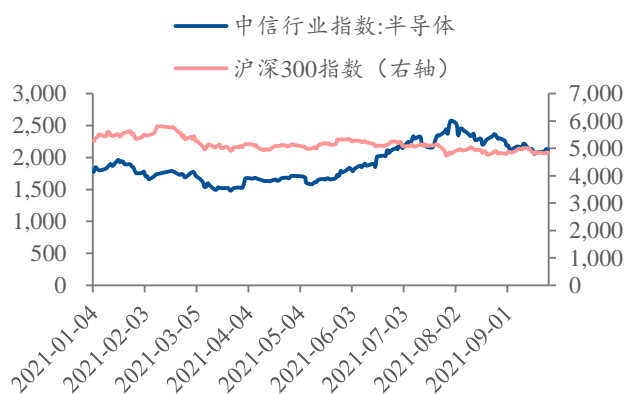
资料来源: wind, 民生证券研究院

图2: 全球半导体月度销售额及增速



资料来源: wind, 民生证券研究院

图3: A股半导体指数



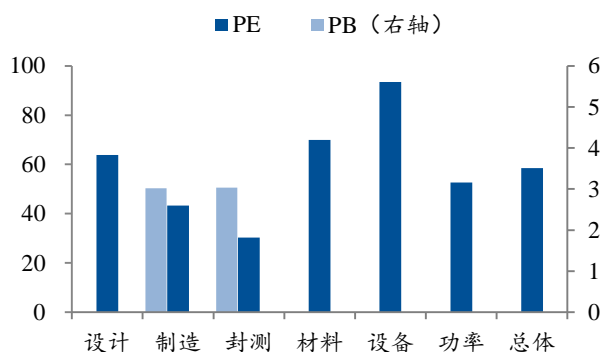
资料来源: wind, 民生证券研究院

图4: 台湾半导体指数



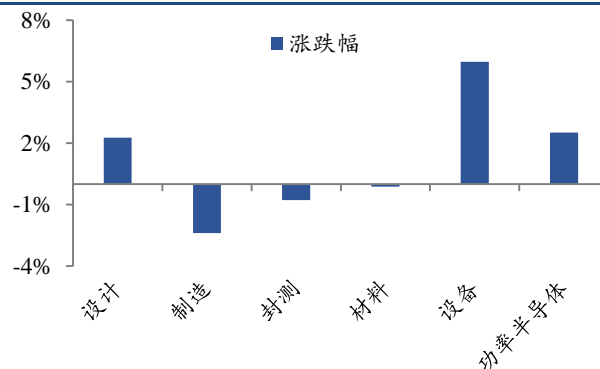
资料来源: wind, 民生证券研究院

图 5：2021-9-24 细分板块估值情况



资料来源：wind，民生证券研究院

图 6：上周半导体各细分板块涨跌幅情况



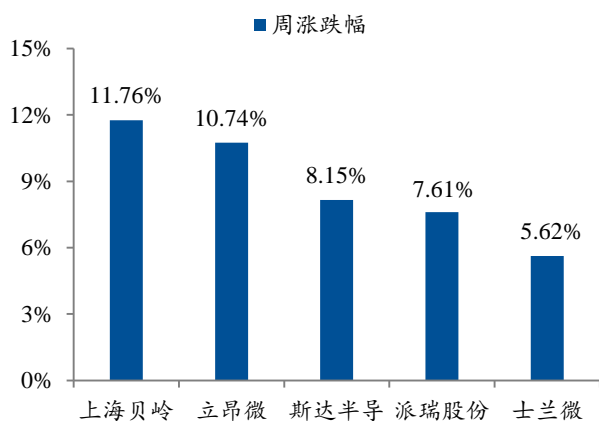
资料来源：wind，民生证券研究院

注：PE=最近市值/2021 年 wind 一致预期净利润

注：PB=最近市值/2021 年 wind 一致预期净资产

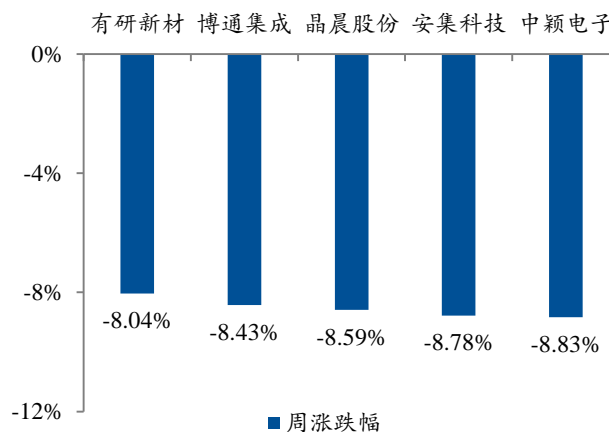
上周（2021/9/20~2021/9/24）半导体行业涨幅前五公司为上海贝岭（+11.76%）、立昂微（+10.74%）、斯达半导（+8.15%）、派瑞股份（+7.61%）和士兰微（+5.62%），涨幅后五的公司为有研新材（-8.04%）、博通集成（-8.43%）、晶晨股份（-8.59%）、安集科技（-8.78%）和中颖电子（-8.83%）。

图 7：上周半导体行业涨跌幅前五公司



资料来源：wind，民生证券研究院

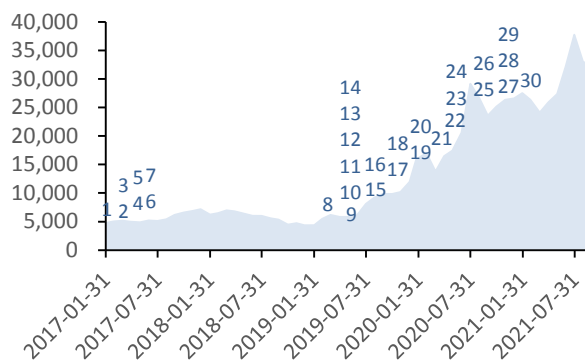
图 8：上周半导体行业涨跌幅后五公司



资料来源：wind，民生证券研究院

截至上周 (2021/9/24), A 股半导体公司总市值达 31,310 亿元, 同比+25%。其中: 设计板块公司总市值 12,194 亿元, 同比+33%; 制造板块公司总市值 7,466 亿元, 同比+18.3%; 设备板块公司总市值 5,358 亿元, 同比+72%; 材料板块公司总市值 4,484 亿元, 同比+35%; 封测公司总市值 1,808 亿元, 同比-10%。

图 9: A 股半导体板块公司总市值 (十亿元)



资料来源: wind, 民生证券研究院

图 11: A 股半导体设计板块公司总市值 (十亿元)

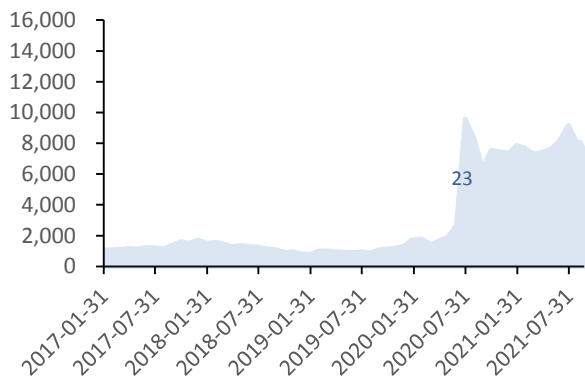
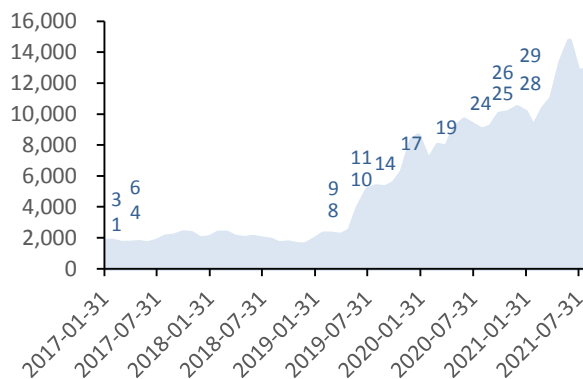
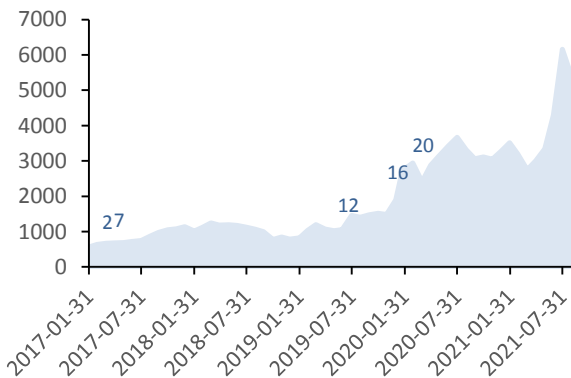


图 10: A 股半导体设计板块公司总市值 (十亿元)



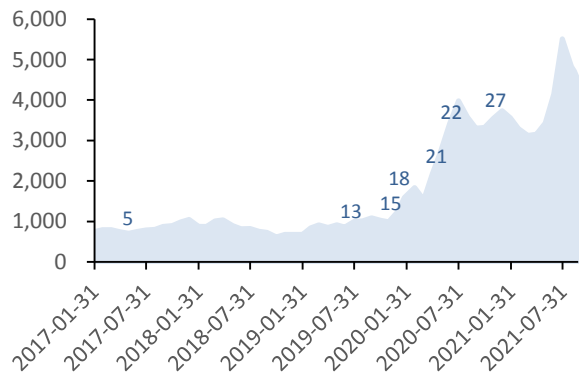
资料来源: wind, 民生证券研究院

图 12: A 股半导体设备板块公司总市值 (十亿元)



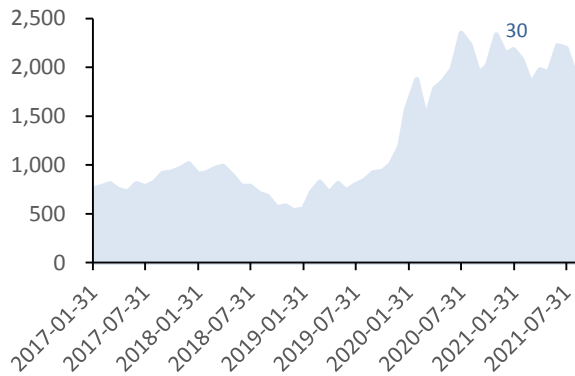
资料来源: wind, 民生证券研究院

图 13: A 股半导体材料板块公司总市值 (十亿元)



资料来源: wind, 民生证券研究院

图 14: A 股半导体封测板块公司总市值 (十亿元)



资料来源: wind, 民生证券研究院

资料来源: wind, 民生证券研究院

- 注 1: 2017/2/20 富瀚微 (300613.SZ) 上市 (影响当月市值 63 亿)
- 注 2: 2017/4/17 长传科技 (300604.SZ) 上市 (影响当月市值 26 亿)
- 注 3: 2017/5/4 韦尔股份 (603501.SH) 上市 (影响当月市值 95 亿)
- 注 4: 2017/6/6 圣邦股份 (300661.SZ) 上市 (影响当月市值 44 亿)
- 注 5: 2017/6/15 江丰电子 (300666.SZ) 上市 (影响当月市值 42 亿)
- 注 6: 2017/7/12 国科微 (300672.SZ) 上市 (影响当月市值 32 亿)
- 注 7: 2017/7/28 中科信息 (300678.SZ) 上市 (影响当月市值 12 亿)
- 注 8: 2019/4/15 博通集成 (603068.SH) 上市 (影响当月市值 69 亿)
- 注 9: 2019/6/18 卓胜微 (300782.SZ) 上市 (影响当月市值 111 亿)
- 注 10: 2019/7/22 乐鑫科技 (688018.SH) 上市 (影响当月市值 132 亿)
- 注 11: 2019/7/22 澜起科技 (688008.SH) 上市 (影响当月市值 874 亿)
- 注 12: 2019/7/22 中微公司 (688012.SH) 上市 (影响当月市值 473 亿)
- 注 13: 2019/7/22 安集科技 (688019.SH) 上市 (影响当月市值 103 亿)
- 注 14: 2019/8/8 晶晨股份 (688099.SH) 上市 (影响当月市值 358 亿)
- 注 15: 2019/11/20 清溢光电 (688138.SH) 上市 (影响当月市值 41 亿)
- 注 16: 2019/12/16 芯源微 (688012.SH) 上市 (影响当月市值 62 亿)
- 注 17: 2019/12/23 聚辰股份 (688123.SH) 上市 (影响当月市值 87 亿)
- 注 18: 2019/12/26 华特气体 (688268.SH) 上市 (影响当月市值 53 亿)
- 注 19: 2020/2/7 瑞芯微 (603893.SH) 上市 (影响当月市值 240 亿)
- 注 20: 2020/2/18 华峰测控 (688200.SH) 上市 (影响当月市值 155 亿)
- 注 21: 2020/4/20 沪硅产业-U (688126.SH) 上市 (影响当月市值 398 亿)
- 注 22: 2020/6/16 金宏气体 (688106.SH) 上市 (影响当月市值 262 亿)
- 注 23: 2020/7/16 中芯国际 (688981.SH) 上市 (影响当月市值 6115 亿)
- 注 24: 2020/7/22 芯朋微 (688508.SH) 上市 (影响当月市值 176 亿)
- 注 25: 2020/8/10 敏芯股份 (688286.SH) 上市 (影响当月市值 72 亿)
- 注 26: 2020/8/18 芯原股份-U (688521.SH) 上市 (影响当月市值 560 亿)
- 注 27: 2020/9/11 立昂微 (688126.SH) 上市 (影响当月市值 393 亿)
- 注 28: 2020/9/21 思瑞浦 (688536.SH) 上市 (影响当月市值 203 亿)
- 注 29: 2020/9/28 芯海科技 (688595.SH) 上市 (影响当月市值 62 亿)
- 注 30: 2020/11/11 利扬芯片 (688135.SH) 上市 (影响当月市值 78 亿)

上周(2021/9/20~2021/9/24)沪/深股通总体减持半导体板块。沪/深股通持股市值前20的企业中,8家企业获增持,12家企业被减持。增持金额前三公司为士兰微(3.9亿元)、圣邦股份(1.6亿元)、北京君正(1.6亿元),减持金额前三公司为韦尔股份(-4.4亿元)、三安光电(-2.6亿元)、紫光国微(-1.8亿元)。

图 15: 沪/深股通半导体板块持仓情况(按持股市值排名)

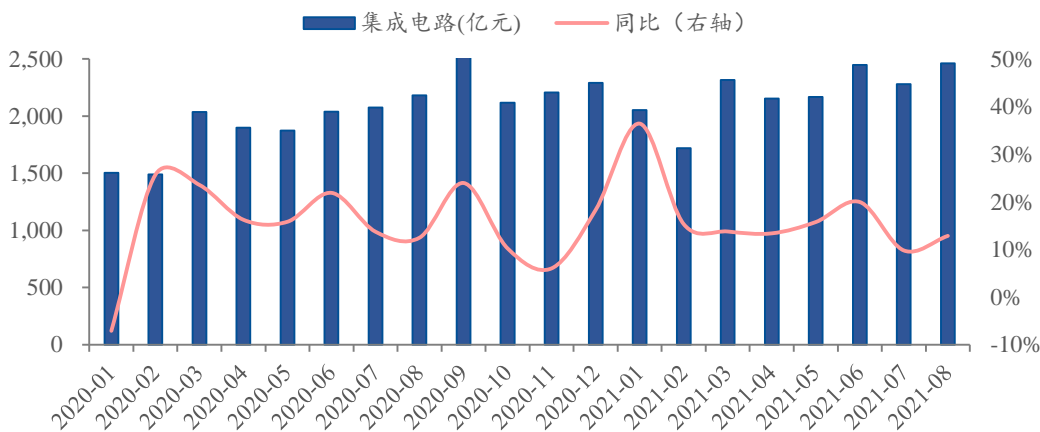
本周排名	上周排名	证券代码	证券简称	一周增减持金额 (百万元)	一月增减持金额 (百万元)	年初至今增减持金额 (百万元)	沪(深)股通持股市值 (百万元)	沪(深)股通持股占 自由流通股比例 %
1	1	603501.SH	韦尔股份	-438	315	6,904	16,401	13.22304404
2	2	002371.SZ	北方华创	-143	141	1,445	9,612	11.58304251
3	3	300782.SZ	卓胜微	-91	587	9,835	7,950	11.84894093
4	4	603986.SH	兆易创新	132	1,597	4,580	7,759	10.47277701
5	5	002008.SZ	大族激光	-31	262	1	6,277	19.16561724
6	6	002129.SZ	中环股份	0	-843	1,602	5,489	5.445941978
7	7	300316.SZ	晶盛机电	-17	762	2,561	4,704	12.11074636
8	8	600745.SH	同泰科技	-37	442	2,282	4,538	6.965692674
9	10	300661.SZ	圣邦股份	162	1,079	2,169	4,195	11.8531473
10	9	600703.SH	三安光电	-263	-454	411	3,875	5.229968186
11	11	002049.SZ	紫光国微	-178	512	1,222	3,157	3.7149325
12	12	603290.SH	斯达半导	45	1,123	2,448	2,448	11.97042802
13	15	600460.SH	士兰微	393	281	484	1,937	4.190938958
14	14	688012.SH	中微公司	151	1,018	1,667	1,667	4.155624427
15	16	688008.SH	澜起科技	-8	166	1,429	1,429	5.958281605
16	13	300327.SZ	中颖电子	-58	-12	853	1,385	9.086175269
17	17	600584.SH	长电科技	-29	-285	1,379	1,327	3.500921419
18	18	300458.SZ	全志科技	15	18	681	1,280	8.32440169
19	20	300223.SZ	北京君正	158	208	878	1,203	5.06368323
20	19	603160.SH	汇顶科技	-13	-104	-72	1,097	4.594876469

注:此表中沪(深)股通持股市值=沪(深)股通持股数量*上周交易均价,数据更新截止于2021/9/24;

资料来源:wind,民生证券研究院

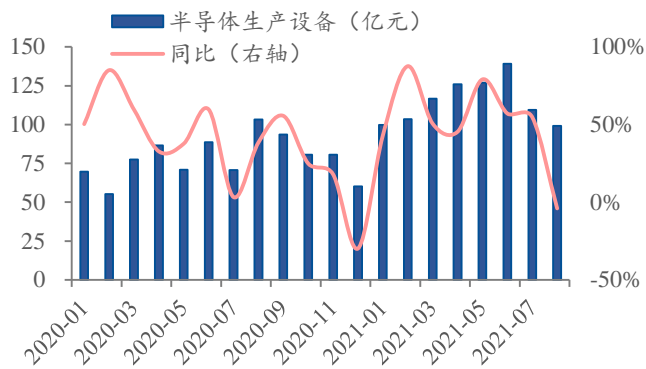
国内下游需求旺盛。根据海关总署最新数据显示,2021年8月我国集成电路进口额为2461亿元,同增13%;半导体生产设备进口额99亿元,同减4%;处理器及控制器进口额为1092亿元,同增5%;存储器进口额为747亿元,同增23%;放大器进口额为96亿元,同增36%。2021年1月-8月,上述进口数据均同比高增长,反应国内需求高景气度。

图 16: 集成电路月度进口数据



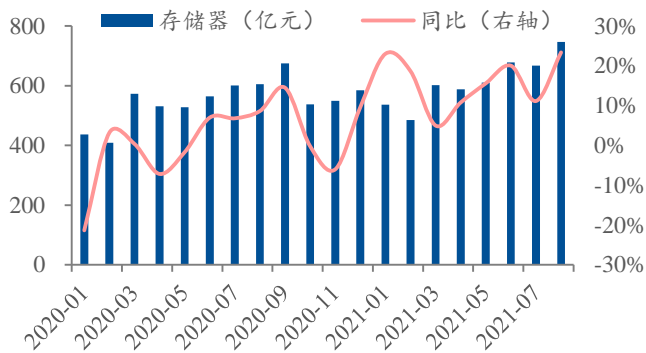
资料来源:海关总署,民生证券研究院

图 17: 集成电路-半导体生产设备月度进口数据



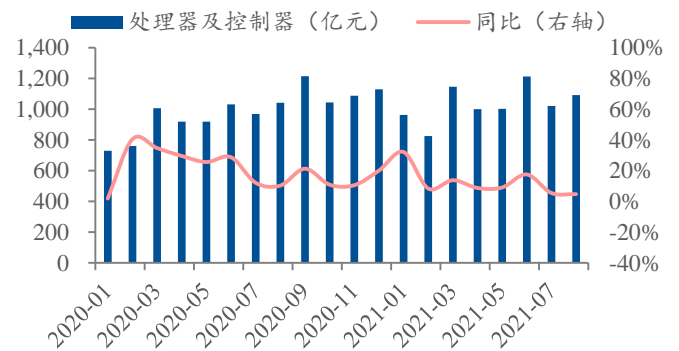
资料来源: 海关总署, 民生证券研究院

图 19: 集成电路-存储器月度进口数据



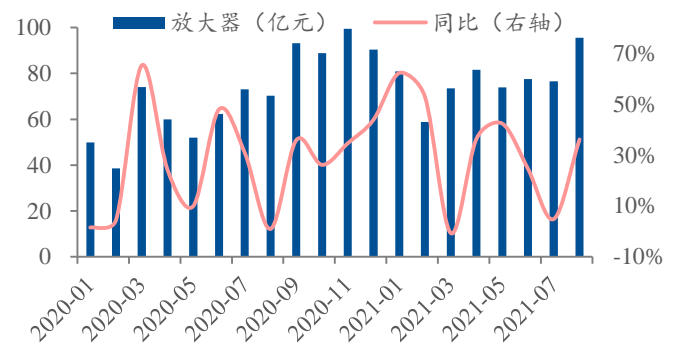
资料来源: 海关总署, 民生证券研究院

图 18: 集成电路-处理器及控制器月度进口数据



资料来源: 海关总署, 民生证券研究院

图 20: 集成电路-放大器月度进口数据



资料来源: 海关总署, 民生证券研究院

2 行业新闻

1) 台积电打造先进封测制造基地，预计今年导入机台

台积电先进封装技术暨服务副总经理廖德堆近日在某高科技智能制造论坛表示，随着先进制程技术朝 3 纳米或以下推进时，具有先进封装的小芯片概念已成为必要的解决方案。台积电 2020 年制程技术已发展至 5 纳米，预计在 2022 年完成 5 纳米的 SoIC 开发。为达到先进小芯片封装制造的上市时间、量产和良率的目标，台积电正打造创新的 3D Fabric 先进封测制造基地，将采全自动化。

台积电积极打造创新的 3D Fabric 先进封测制造基地，将由紧密连结的 3 座厂房所组成，其中 SoIC 厂房将于今年导入机台，另一 2.5D 先进封装厂房预计明年完成。

据了解，先进封装技术主要是透过小芯片或芯片块设计架构，搭配高频宽存储器（HBM）或特殊型 DRAM，客户针对不同 AI、HPC 应用，打造出效能强大的处理器或加速器。

2) 华为 9 月 25 日将发表欧拉新操作系统

周四（23 日）华为宣布将在周六（25 日）发表全新的操作系统-欧拉（openEuler）。欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。

与鸿蒙 OS 系统定位在终端消费性电子产品不同，欧拉操作系统是朝向服务器领域。服务器储存着大量的数据，为了有效解决数据资料的安全问题与硬件能流畅运作，操作系统具有举足轻重的地位。

欧拉是一个开源、免费的 Linux 平台，将透过开放的社区形式与全球的开发商共同构建一个开放、多元和架构包容的软体生态体系。同时，欧拉也是一个创新的平台，鼓励任何人在该平台上提出新想法、开拓新思路、实践新方案。

3) 全球晶圆代工产值今年可望首破千亿美元

研调机构 IC Insights 预估，今年全球晶圆代工产值可望首度突破 1000 亿美元关卡，达到 1072 亿美元，年增 23%。其中网路、数据中心、5G 智能手机用的先进处理器，及机器人、自驾车、驾驶辅助自动化、人工智能、机器学习及影像识别芯片需求强劲，是推升晶圆代工产值成长主要动能。

IC Insights 指出，台积电及联电等晶圆代工厂今年营收可望稳健成长，预期今年纯晶圆代工市场产值可望达 871 亿美元，将成长 24%，增幅将高于去年的 23% 水准。

2025 年纯晶圆代工市场产值可望攀高至 1251 亿美元规模，将占整体晶圆代工市场总产值的 82.7%。IC Insights 预估，2020 年至 2025 年年复合成长率将约 12.2%。三星（Samsung）等整合元件制造（IDM）厂今年晶圆代工产值将达 201 亿美元，年增 18%，2025 年可望达 261 亿美元规模，年复合成长率约 9%。2025 年全球晶圆代工总产值将达 1512 亿美元。

4) EDA 上市潮涌，继华大九天后，概伦电子也 IPO 过会

9月22日，据上交所披露，上海概伦电子首发申请获准，将于上交所科创板上市。至此，这家国产EDA厂商的科创板上市之路已跨过关键一道坎，距离成功登陆科创板更近一步。

不久前，在九月初时，国内EDA龙头华大九天已于创业板过会，而这次概伦电子赶在九月底的尾巴冲刺科创板，业界围绕两家“EDA第一股”之争的话题变得更为火热。

5) 富智康续扩印度市场，估半导体吃紧仍需1年调整

据台湾中央社报道，富士康旗下富智康表示，半导体元件供应吃紧未解，预估需再1年调整，下半年市况仍有海运和通胀变数，不过富智康持续扩展印度市场业务。

展望下半年营运市况，富智康在年度中期报告指出，半导体元件供应短缺仍是极重要的课题，供应吃紧问题仍无法解决，预估再经历1年的调整周期，此外，受到海运限制和全球通胀威胁，可能使下半年供需市况更多不确定因素。

富智康表示会持续在印度市场扩展业务，今年上半年印度占富智康整体业绩比重约33%。

今年上半年来自富士康集团营收占富智康整体营收比重约31.2%。从客户来看，日本夏普(Sharp)占富智康整体业绩比重约12.8%，Ensky Technology占比约16.8%。今年上半年前5大客户占业绩比重约96.3%。法人推测富智康前5大客户包括华为、小米、OPPO、Ensky和夏普。

插图目录

图 1: 费城半导体指数持续上涨.....	5
图 2: 全球半导体月度销售额及增速.....	5
图 3: A 股半导体指数.....	5
图 4: 台湾半导体指数.....	5
图 5: 2021-9-24 细分板块估值情况.....	6
图 6: 上周半导体各细分板块涨跌幅情况.....	6
图 7: 上周半导体行业涨跌幅前五公司.....	6
图 8: 上周半导体行业涨跌幅后五公司.....	6
图 9: A 股半导体板块公司总市值 (十亿元).....	7
图 10: A 股半导体设计板块公司总市值 (十亿元).....	7
图 11: A 股半导体设制造块公司总市值 (十亿元).....	7
图 12: A 股半导体设备板块公司总市值 (十亿元).....	7
图 13: A 股半导体材料板块公司总市值 (十亿元).....	7
图 14: A 股半导体封测板块公司总市值 (十亿元).....	7
图 15: 沪/深股通半导体板块持仓情况 (按持股市值排名).....	9
图 16: 集成电路月度进口数据.....	9
图 17: 集成电路-半导体生产设备月度进口数据.....	10
图 18: 集成电路-处理器及控制器月度进口数据.....	10
图 19: 集成电路-存储器月度进口数据.....	10
图 20: 集成电路-放大器月度进口数据.....	10

表格目录

分析师与研究助理简介

王芳，电子行业首席，曾供职于东方证券股份有限公司、一级市场私募股权投资有限公司，获得中国科学技术大学理学学士，上海交通大学上海高级金融学院硕士。

杨旭，电子行业分析师，曾供职于东方证券股份有限公司，复旦大学理学博士。

王浩然，电子行业分析师，曾任职于东吴证券股份有限公司，2019年新财富环保行业第三名团队核心成员，获上海财经大学理学学士、金融硕士。

赵晗泥，电子行业研究助理，2020年加入民生电子，曾就职于外资行业研究，爱丁堡大学经济学硕士，复旦大学经济学学士。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测未来股价涨幅 15% 以上
	谨慎推荐	分析师预测未来股价涨幅 5%~15% 之间
	中性	分析师预测未来股价涨幅-5%~5% 之间
	回避	分析师预测未来股价跌幅 5% 以上
行业评级标准		
以报告发布日后的 12 个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测未来行业指数涨幅 5% 以上
	中性	分析师预测未来行业指数涨幅-5%~5% 之间
	回避	分析师预测未来行业指数跌幅 5% 以上

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路8号财富金融广场1幢5F； 200120

北京：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座18层； 100005

深圳：广东省深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01 单元； 518001

免责声明

本报告仅供民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。

本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或参与本报告所提及的公司的金融交易，亦可向有关公司提供或获取服务。本公司的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任本报告所提及的公司的董事。

本公司及公司员工在当地法律允许的条件下可以向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务以及顾问、咨询业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。

未经本公司事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以其他方式发送、传播本报告。本公司版权所有并保留一切权利。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。